

HI

>> Hot Issue

IT-SoC Fair 2006

〈IT-SoC Fair 2006〉

구석구석을 살펴본다

매년 가을이 되면 각종 IT 관련 행사가 펼쳐진다. 대형 전시회부터 크고 작은 세미나나 컨퍼런스가 연일 개최된다.

각 기업들도 한해의 마감을 앞두고 풍요로운 결실을 맺기 위해 동분서주한다. 우리 SoC기업들도 예외는 아니다. 특히 전통적으로 4사분기에 가장 많은 분기 매출을 보여주고 있는 SoC기업들은 요즘 더욱 바쁜 시기를 보내고 있다. 이런 분주함 속에서 SoC기업들과 관련 종사자들이 한자리에 모여 최신 기술과 제품을 선보이고 미래의 기술과 시장을 전망해보는 의미 있는 행사가 열린다.

국내 유일의 SoC/IP 전문전시회 〈IT-SoC Fair 2006〉

정보통신부가 주최하고 정보통신연구진흥원, IT-SoC협회, 한국전자통신연구원이 주관하는 'IT-SoC Fair 2006'이 오는 11월 1일~2일 양일간 COEX 인도양홀에서 개최된다. 이 행사는 Fabless 반도체업체들이 중심이 되는 SoC(System on Chip)/IP(Silicon Intellectual Property)전문 전시회이자 국내 유일의 전시회이다.

행사를 주관하고 있는 IT-SoC협회의 황중범 사무총장은 "올해는 전문성 강화와 참가업체의 마케팅 활동의 효율성 증대에 행사의 포커스를 맞추고 기획단계에서부터 업계의 의견을 최대한 반영하여 치밀한 준비해왔다."고 하면서 "비록 역사가 긴 전시회는 아니지만 매해 더욱 내실 있는 행사로 거듭나고 있다."고 말해 나날이 질적, 양적 성장을 해가고 있는 전시회라는 점을 강조했다.

'IT-SoC Fair 2006'은 메인행사인 전시회를 포함하여 컨퍼런스, 비즈니스 상담회, SoC Night, Job Fair 등 다채로운 부대행사가 함께 개최된다. 비즈니스 전시회, 기술 전시회, 전문 전시회를 표방하고 있는 'IT-SoC Fair 2006'은 'The Marketplace For Future Technologies!'라는 Moto에 걸맞게 알찬 프로그램으로 가득 차 있다.

〈IT-SoC Fair 2006〉에서는 어떤 행사가 펼쳐질까?

이번 행사의 메인인 전시회에는 코아로직, 티엘아이, 토마토엘에스아이, FCI, 넥스트칩 등 국내 IT SoC업계를 이끌어가는 주요 업체를 비롯하여 대만, 미국, 이스라엘 등 각국의 SoC관련 45개 업체가 참가하여 최신 기술과 신제품을 선보인다.

코아로직은 자사의 주력 제품인 MAP(Multimedia Mobile Processor)를 비롯하여 CAP(Camera Application Processor), ISP(Image Signal Processor)등을 선보인다. 대형 TFT-LCD Timing Controller로 작년보다 눈부신 성장을 하고 있는 티엘아이는 비교적 큰 규모의 부스로 참가해 높아진 회

사의 위상을 보여준다. 이외에도 작년에도 참가했던 Socle과 올해 처음으로 참가한 ISTI, Samhop, Semiconductor Insight 등 해외 업체들도 자사의 기술과 제품을 선보여 예정이어서 IT-SoC Fair가 점차 국제전시회로서의 면모를 갖춰가고 있음을 보여주고 있다.

이번 행사에서 전시회만큼 큰 비중을 두고 있는 컨퍼런스는 "Digital Convergence & Fusion Technology"라는 주제로 휴대폰, 모바일 방송, WiBro, RFID/USN, 홈네트워크 분야의 발전 방향과 시스템의 변화에 대해 심도 있는 논의가 이루어질 예정이다.

삼성전자, LG전자, KTF 등 대기업의 임원들을 비롯하여 학계, 연구소, 벤처기업의 전문가들이 연사로 나와 핵심기술에 대한 강연과 향후 펼쳐질 시장에 대한 전망 등으로 프로그램이 구성되어 있어 특히 그 관심이 집중된다. 이런 관심을 입증이라도 하듯 온라인 참가신청을 개시하기가 무섭게 수십 명의 등록자가 몰리기도 해 시작 전부터 높은 호응도를 보였다.

컨퍼런스 준비의 실무책임 맡은 IT-SoC협회 이민영 팀장은 "수준 높은 프로그램을 짜기 위해 수개월 전부터 각 분야의 전문가들로 기획위원회를 구성하여 수차례의 회의와 토론을 거쳤고, 최고 수준의 연사를 섭외하기 위해 백방으로 뛰어 다녔다."라고 말하면서 "직접 와서 강연을 들으면 그 가치를 알 수 있을 것"이라며 행사에 대한 자신감을 표했다.

올해에 또 한 가지 달라진 점은 전시장 내에 PT나 세미나를 할 수 있는 공간을 마련했다는 점이다. 좁은 부스에서 자사 제품을 홍보하거나 제품시연 등을 하기에 난점이 있어 주최 측에서 특별한 공간을 마련한 것이다. 특히 세계적인 전문지인 '전자엔지니어' 등의 잡지를 발행하고 있는 글로벌 소시스에서는 EETimes-China의 책임편집장과 영업책임자가 전시장내에 마련된 PT룸에서 국내업체 관계자들에게 효과적인 중국시장 진출의 방법에 대한 강연을 준비하고 있다고 한다.

비즈니스상담회도 새로운 기획으로 다시 태어났다. 올해 3회째 개최되는 비즈니상담회는 국내 SoC기업들의 중국시장 진출의 교두보 역할을 톡톡히 하면서 성과위주의 행사로 거듭나고 있다. 기업에서 실질적인 구매권을 가지고 있는 담당자들 위주로 초청단을 구성하여 구매계약 성사까지 더욱 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 했다.

특히 중국 바이어들의 한국 SoC기업들에 대한 관심이 높아져 과반수 이상이 자비로 방한을 할 예정이다.

이외에도 국내외의 SoC 관련 기업, 연구소, 정부기관 인사들이 한자리에 모여 친목을 도모하는 SoC Night 2006 행사와 2006 IT SoC 대상 시상식 등 다채로운 행사가 펼쳐진다. 또한 전시 기간 중 다채로운 이벤트와 경품 행사가 펼쳐질 예정이어서 참가객들에게 또 다른 즐거움을 선사한다.

풍요의 계절인 가을, IT-SoC Fair는 SoC인들이 한자리에 모여 서로의 첨단 기술을 뽐내는 경연장이자 축제의 마당으로 자리매김하고 있다.

정보통신기기에 쓰이는 핵심기능을 하나의 칩에 구현하는 IT SoC(System on Chip)은 대한민국의 자랑인 휴대폰, LCD 디지털TV의 핵심 부품으로 국민소득 2만불 시대를 견인할 핵심 산업이다. 최근 몇 년간 정부에서는 IT SoC산업의 중요성을 인식하고 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있으며, 향후에도 대한민국을 이끌어갈 신성장동력의 하나로 지속적인 관심을 가지고 지원을 한다는 방침을 세우고 있다. 하지만 한국의 SoC산업은 아직은 태동기로 우리나라 경제규모에서 차지하는 비중이나 세계시장에서의 점유율은 많지 않다. 그럼에도 불구하고 매년 독자적인 전시회를 개최한다는 것은 의미하는 바가 크다. 이와 같은 행사를 통해 한국 SoC산업의 놀라운 성장력과 발전가능성을 보여주고, 이로 인해 대국민적 관심과 정부의 지원을 이끌어 낼 수 있는 토대가 마련되기 때문이다. 메모리반도체는 반도체 강국이라는 한국의 위상을 굳건히 했다. 이제는 SoC로 반도체 세계제패 할 날을 기대한다.

● 행사개요

- 행사명 : IT-SoC Fair 2006
- 장 소 : 서울 COEX 인도양홀
- 일 시 : 2006년 11월 1일(수)~2일(목), 2일간
- 주 최 : 정보통신부
- 주 관 : 정보통신연구진흥원, IT-SoC협회, 한국전자통신연구원
- 후 원 : 삼성전기, 코아로직, 전자신문사, FSA

● 전시 품목

- SoC(System on Chip)/IP(Silicon Intellectual Property) 제품
- System-in-Package Solution
- Embedded System H/W · S/W
- PLD/FPGA
- SoC Design Tool(EDA)
- Package and Test Service
- Foundry Service
- 센서 및 IT융합부품

● IT-SoC Fair 2006 참가업체



2006 IT SoC 대상

『대상』수상기업 (주)넥실리온(대표이사 배성욱)

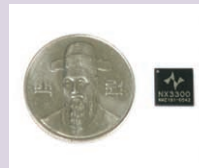


넥실리온은 2001년 9월에 설립된 반도체칩 개발 및 설계 전문회사입니다. 2006년 3월, 지상파DMB 수신용 Baseband 및 A/V decoder 통합칩을 양산 공급함으로써 칩 업계에 이름을 알리기 시작하였으나, 그 이전에도 비표준 TV 신호처리 IC, Network Processor 등을 양산한 경험을 가지고 있습니다. 현재 R&D 인력 17명을 포함하여 총 22명의 소규모 회사임에도 불구하고, SoC 사업을 영위하기 위한 Processor Architecture, Algorithm Analysis, Low Power, Analogue IP integration 등의 기초기술과 Embedded Processor, Digital A/V codec, MODEM, USB나 PCI 등의 IP 등 각종 요소기술을 자체 보유하고 있는 기술 집약 벤처기업입니다. 회사에 집적되어 있는 MODEM 및 multi-media 관련 기술을 활용하여 지상파DMB 뿐만 아니라, DVB-H나 ISDB-T 등 mobile TV SoC 분야에서 향후 3년 이내에 세계 최고기업으로 발돋움하려는 비전을 가지고 있습니다.

넥실리온은 지상파DMB 통합칩 공급 원년인 금년에 약 2백만개로

예상되는 지상파DMB 단말기 시장에서 약 60만개 가량을 공급할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

수상제품 소개 : 지상파 DMB 수신 통합칩 - NX3300



NX3300은 지상파DMB 수신을 위해 필요한 RF, baseband 및 Audio/Video decoder 등 3대 기능 중 baseband와 Audio/Video decoder를 통합한 칩입니다. NX3300은 Eureka-147 baseband decoder, H.264 video decoder, audio decoder, 다양한 인터페이스, 4MByte SDRAM을 내장하여 집적도 면에서 세계 최고 수준이며, 전력소모도 지상파 DMB 수신시 75mW로써 업계 최저 전력입니다. Package는 161ball, 0.5mm pitch, 8mm x 8mm FBGA로 업계 최소형이므로 지상파 DMB 수신용 슬림 폰이나 초소형 모듈 등의 구현에 매우 적합합니다. 또한, 내장된 프로세서를 이용하여 high level API를 제공하므로 응용 S/W 개발 기간을 줄일 수 있습니다.

CEO 인터뷰

배성욱 대표이사

1. 넥실리온이 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있는 부분이 무엇입니까?

회사의 기술 경쟁력이 제품으로 나타난다고 봤을 때 먼저 저회 제품의 기술적인 장점을 봐야 할 것 같습니다. 저희 칩의 가장 큰 장점으로는 최소 소비 전력과 최소 크기를 들 수 있습니다. 이러한 기술적인 성과는 전용하드웨어 방식의 멀티미디어 디코더 및 OFDM baseband 기술과 이들 기본 블록 및 RISC core를 하나의 메모리 상에서 동작할 수 있게 해 주는 "통합 메모리 구조"기술에 의해 얻어진 것입니다. 이외에 RISC core를 내장하고 high-level s/w API 를 제공하여 전용하드웨어 방식 제품의 문제점들을 보완한 것도 성공의 큰 요인 중에 하나입니다. 요약해서 말씀드리면 저전력을 실현할 수 있는 전용하드웨어 방식의 멀티미디어 디코더 및 OFDM 기반의 방송 수신용 basedband 기술과 이들을 RISC core와 유기적으로 통합시키는 기술 및 high-level s/w API 개발 기술 등이 넥실리온의 핵심기술이라고 말씀드릴 수 있습니다.



2. 현재 넥실리온이 집중하고 있는 DMB 베이스밴드 분야가 향후 어떤 기술적 발전을 하리라고 예상하십니까?

현재는 국내에서 시작된 T-DMB 가 선두를 달리고 있지만 향후 노키아가 주축이 되어 개발하고 있는 DVB-H, 일본에서 시작되어 브라질에서 채택된 ISDB-T, 중국에서 자국 표준으로 개발하고 있는 DVB-HT 등이 세계의 Mobile TV 시장을 놓고 치열한 경쟁을 할 것으로 예상됩니다. 따라서 여러 가지 방식의 방송 표준을 동시에 지원하는 멀티표준 베이스밴드로 발전할 것이며 이와 더불어 제품 소형화를 위한 RF 기능의 집적도 동시에 진행될 것으로 봅니다.

3. SoC기업이 향후 기술 개발에 집중해야할 분야를 꼽는다면 어떤 분야를 꼽을 수 있습니까?

특정 분야를 선택해서 말씀드리기는 어렵습니다. 다만 이동성을 좀 더 신장시키면서 다양한 정보를 손쉽게 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 방향으로 나아갈 것으로 봅니다.

4. 제품 개발 과정에서 어려운 점이 있다면 어떤 점이 있습니까?

모든 회사가 다 마찬가지이지만 인력과 자금입니다. 칩 개발에 필요한 개발 환경은 IT-SOC 사업단에서 지원을 받고 있어서 큰 문제가 없었습니다만 어느 정도 가시적인 성과가 나오기 전까지는 벤처 투자사로부터 투자 유치를 하기도 어렵고 좋은 인력을 데려오기도 어려웠습니다. 다행히 칩 제작 및 필요장비 구매 자금은 정통부의 정보통신산업경쟁력강화사업의 도움을 받았으며 인력문제는 어려운 상황에서도 임직원분들의 헌신적인 노력으로 극복할 수 있었습니다. 이 자리를 빌어 정통부 관계자 분들과 임직원 여러분께 다시 한번 감사를 드립니다.

5. 향후 SoC 산업이 기술적 발전을 계속하려면 무엇이 필요하다고 보십니까?

SoC 산업의 발전은 지속적인 인재 육성에 있다고 달려 있다고 생각합니다. 정통부 및 산하 관련 단체에서 인재육성 관련한 많은 일을 하고 계시는 것으로 알고 있습니다. 이러한 프로그램들을 단기적인 성과에 연연하지 않고 꾸준히 지속해 나가는 것이 중요합니다. 또한 이 분야에서 함께하고 있는 미래의 인재들에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 환경을 만들어 줄 수 있으면 좋겠습니다. "졸업 후 기업체 연구원"과 같은 도식적인 미래상에서 벗어나 자기 삶을 주도적으로 이끌어 나갈 수 있는 기회를 제공한다는 측면에서 능력과 실력을 갖추면 누구나 "창업을 통한 자아실현의 기회"를 이 사회가 더 많이 제공해 줄 수 있다면 지속적인 인재 확보를 통해 SoC 산업이 꾸준히 발전해 나갈 것이라고 기대해 봅니다.

『신기술상』수상기업 (주)넥스트칩(대표이사 김경수)

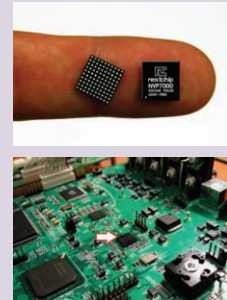


(주)넥스트칩(대표 김경수 <http://www.nextchip.com>)은 1997년에 설립된 팹리스 반도체 회사로서 창업 이래 비디오신호처리 분야에 연구 개발 투자를 집중한 영상보안 분야 전문업체입니다. 당사의 강점은 보안 시스템의 토털 칩 솔루션을 확보하고 있다는 점입니다. CCTV Camera ISP, Multi-Standard TV Video Docoder, Video Controller, Video Codec(JPEG, MPEG4)의 분야를 모두 포함한 Video Security System의 모든 라인업을 갖춘 Total Solution의 IP를 자체 기술진에 의해 개발했습니다. 따라서 당사의 제품만으로도 전체 시스템을 구성할 수 있습니다. 넥스트칩은 영상보안 사업 분야에서 2005년에 160억의 매출을 올렸고, 2006년에는 약 265억원의 매출을 기대하고 있습니다. 보안시스템 분야에서 축적된 기술력과 핵심 IP를 한 층 더 업그레이드시켜 개발에 성공하여 이번에 전자부품기술대상을 수상하게 되는 본 제품을 통해 기존의 영상보안 시장 외에 일반 소비자가 전 시장에도 진출하여 멀티미디어 SoC 분야의 진정한 강자로서 자리매김을 할 것으로 기대하고 있습니다.

수상제품 소개 :

Multi-Standard Video Decoder/Encoder – NVP7000

Analog Video를 Digital 영상 규격 신호로 변환하는 역할(Decoder)과 Digital Signal을 Analog Video 영상 규격신호로 변환하는 역할(Encoder)을 담당합니다. 국내 최초로 Video Decoder와 Video Encoder를 하나의 칩으로 집적한 국내 최초의 제품입니다. 두 가지 기능을 하나에 집적하면서도 개별적인 기능에 손상을 주지 않았으며, 서로 최고의 기능과 성능을 유지할 수 있도록 하여 제품을 구성하였습니다. 또한 경쟁제품 대비 저전력 설계로 구성되어 비교우위를 가지며, 일부 부가적인 기능을 지원하여, 다양한 Application에서 사용이 가능하도록 하였습니다. 적용될 수 있는 Application은 DMB, Camcorder, PMP, MP3 Player 등 향후에 소비자가전 시장을 선도할 가능성이 높은 분야들이라고 할 수 있겠습니다. 본 제품은 막대한 수입대체 효과와 수출효과가 기대되며, 시장 선도 가능 및 강화 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.



CEO 인터뷰

김경수 대표이사

1. 넥스트칩이 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있는 부분이 무엇입니까?

주요 핵심 IP 기술을 개발하여 독자적인 SoC Platform 구축을 통한 Multimedia SoC 설계기술을 보유하고 있습니다. 경쟁사들은 일부 한두 분야에만 기술력을 보유하고 있는데 반해, 넥스트칩은 CCTV Camera ISP, Multi-Standard TV Video Docoder, Video Controller, Video Codec(JPEG, MPEG4)의 분야를 모두 포함한 Video Security System의 모든 제품 라인업을 갖춘 Total Solution을 보유하고 있는 것이 가장 큰 강점입니다.



2. 현재 넥스트칩이 집중하고 있는 멀티미디어용 IC 분야가 향후 어떤 기술적 발전을 하리라고 예상하십니까?

지금까지의 Security System 에 적용되는 Multimedia 제품에서 안정적인 SoC Platform 과 주요 IP 의 지속적인 개발을 통해서 Advance TV, Portable 기기 에 최적의 Solution을 구축 하고 시장의 Need 에 적기에 대응할 수 있는 경쟁력 있는 기술을 만들어 가고 있습니다.

3. SoC기업이 향후 기술 개발에 집중해야할 분야를 꼽는다면 어떤 분야를 꼽을 수 있습니까?

Digital Convergence 시대에서 복합적인 기능과 One Chip 화의 절대적인 필요성이 대두 되고 있고 반도체 설계 기술의 발달과 공정 기술의 발달, Package 기술의 발달로 통신 및 Multimedia 가 One Chip 화 되고 있으며 IP 의 공유를 통한 공동 개발의 사업 형태도 나타나고 있습니다.

이러한 대세 속에서 저동작전력(LOP) 및 저대기전력(LSTP) 시스템을 비롯한 저전력 SoC 시스템의 중요성이 날로 증가하며, 특히 leakage current를 줄이는 것이 핵심 기술이 될 것입니다. SoC에는 power management unit의 도입이 필수적이 될 것이며, 대기 전력 및 동작 전력을 줄이기 위한 multiple-Vt, multiple-Tox, multiple-Vdd 등의 여러 가지 기법이 적용될 것이며 하드웨어 기술로 전력 소모를 줄이는 것에는 한계가 있기 때문에 소프트웨어적인 기술도 적극 개발되어야 할 것입니다.

Fabless 업체가 직접적으로 개발할 분야는 아니지만 assembly 및 packaging 기술의 중요성이 중요한 비중을 차지할 것 입니다. SoC의 성능을 높이고 설계시간을 단축하기 위해서 chip과 packaging의 설계를 동시에 진행하는 chip and package co-design 이 개발되어야 할 것입니다.

4. 제품 개발 과정에서 어려운 점이 있다면 어떤 점이 있습니까?

국내에 있는 대부분의 Fabless 회사들이 공통적으로 갖고 있는 인력 수급의 어려움과 Foundry, Package 및 Test 산업이 대만, 중국에 비교해서 경쟁력이 부족한 점입니다.

인력의 부족은 시장의 Need에 적기에 제품을 출시 할 수 없는 문제점을 갖고 있고 SoC 기반 산업의 부족은 가격 경쟁력에서 취약점으로 나타납니다.

5. 향후 SoC 산업이 기술적 발전을 계속하려면 무엇이 필요하다고 보십니까?

SoC 는 기술적 기능 구현 뿐만 아니라 개발 목표로 하는 시스템의 이해와 향후 Trend 까지도 볼 수 있어야 합니다. SoC 가 시스템의 사양을 Lead 하고 Total Solution 을 제공해야만 Global SoC 기업으로 성장할 수 있는 바탕이 될 수 있습니다.

이를 위해서 SoC설계 기술 뿐만 아니라 마케팅, Middle ware, Technical Support 의 균형적인 발전이 필요하다고 생각합니다.

『Best Product상』수상기업 (주)매직아이(대표이사 손해운)

MAGIC EYES

(주)매직아이는 지난 '97년 12월, 멀티미디어 칩 설계에 대한 축적된 기술과 경험을 가진 삼성전자의 전문 기술 인력들이 설립한 삼성전자 사내벤처 1호 기업으로 출발, 디지털 컨버전스를 위한 최상의 멀티미디어 SoC와 시스템 솔루션을 제공하는 멀티미디어 SoC 개발 전문업체이다. 매직아이는 인텔, TI 등 외국 반도체 업체가 독주하고 있던 비메모리 반도체 분야에서 국산화를 이루겠다는 목표아래, 창립 때부터 비메모리의 핵심인 SoC(System on a Chip) 개발에 전력 투구하여 2000년 4월, 국내 최초로 휴대용 멀티미디어 원칩 솔루션인 MMSP(모델명)을 개발하는데 성공하였고, 이후 PMP 사업을 하면서 얻은 멀티미디어 시스템 시장에서의 경험으로 MMSP2(모델명)와 Vrender 3D(모델명)를 출시, 본격적인 멀티미디어 칩솔루션 공급회사로서 변신을 꾀하였다. 또한 SoC 기술력을 대외적으로 인정 받아 정보부의 정보기기 시스템원칩 공동연구개발, 산자부가 주관하는 post pc platform국책과제, ETRI 선도기반 기술개발사업 과제 등 정부의 주요국책과제를 수행하였으며 국내 및 일본, 미국의 반도체 관련 업체 및 시스템 업체와 함께 칩을 개발한 경험도 풍부하다. 현재 매직아이의 칩은 기존 외산 제품들을 제치고, 네비게이션, PMP등 국내외 대다수의 멀티미디어 시스템에 채택되어 점유율이 점차적으로 확대되고 있으며, 특히 멀티미디어 네비게이션 시장에서 선두를 달리고 있다. 매직아이는 향후 네비게이션, PMP, DMB, 디지털 카메라 등

멀티미디어 시스템 시장이 요구하는 기능을 더욱더 수용,강화하여 디지털 컨버전스 환경에 대비한 최적화된 핵심 칩솔루션을 공급함으로써 시스템 제조사들이 혁신적인 멀티미디어 시스템 개발이 가능하도록 서비스하는 것을 목표로 전진하고 있다.

수상제품 소개 : 멀티미디어용 프로세서 MMSP2

MMSP2는 멀티미디어용 프로세서로서, Video 및 Image, Graphic과 같이 멀티미디어 성능에 중요한 영향을 미치는 IP들을 매직아이에서 자체 개발하여 ARM core 등과 함께 설계, 독자기술로 자체 개발되었다. 임베디드용으로는 드물게 듀얼 Core 적용하였고, 국내에서는 최초로 듀얼 core를 채택한 멀티미디어 어플리케이션 프로세서임. MMSP는 듀얼 CPU를 포함하여 각종 비디오, 그래픽, 이미지, 인터페이스 기능 등을 통합하여 One Chip으로 개발되었으며, Video, Video post, 2D graphic, Image 등 4개의 독립적인 프로세서가 HW블록으로 구성되었고, 4개의 각 프로세서는 독립적으로 기능을 수행하여 여러개의 화면에서도 비디오와 함께 다양한 비주얼 효과들을 display할 수 있다. 또한 Video CD, JPEG, DivX, Xvid, MPEG4 등 다양한 비디오 포맷의 콘텐츠를 640*480, 30fps의 고성능으로 지원하고 있으며, SD/ MMC/CF 등 각종 카드 및 I2C, AC97, UART, USB 등 멀티미디어 시스템에 필요한 다양한 인터페이스의 지원으로 외부에 별도의 회로 없이도 시스템 기능확장이 용이하다.



CEO 인터뷰

손해운 대표이사

1. 매직아이가 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있는 부분이 무엇입니까?

칩을 파는 회사에서 기술적 우위라고 하면 보통 칩의 기능적인 면에 있어서만 보게 되는 오류를 범하는 경우가 많습니다. 물론 칩의 기능이 아주 중요한 부분이지만, 기술적 우위를 따지는 데 있어서 전부는 아닙니다. 예전과는 달리 요즘 SOC 회사에서의 기술적 경쟁력을 따지는데 있어서는 칩 자체의 경쟁력은 물론이고, 여기에서 칩의 기능을 잘 활용할 수 있게 하는 Software 개발력과 고객이 쉽게 제품을 만들게 하는 레퍼런스 디자인과 개발 보드를 개발하는 Hardware 실력, 고객의 문제를 빨리 해결하는 응용기술의 경험 등을 같이 봐야 합니다. 매직아이는 칩 자체 있어서는 경쟁사 보다 강력한 멀티미디어 기능과 그래픽 처리 기능, 다양한 인터페이스 등을 제공하고 있으며, 이를 뒷받침하는 비디오코덱 과 디바이스 드라이버 등의 Software 와 네비게이션 등의 제품을 손쉽게 만들 수 있는 Hardware 인 레퍼런스 디자인, 그리고 40 개 이상의 모델의 개발을 지원한 경험을 가진 응용기술팀이 경쟁사에 비하여 기술적 우위에 있는 부분이라고 말할 수 있습니다.



2. 현재 매직아이가 집중하고 있는 멀티미디어용 IC 분야가 향후 어떤 기술적 발전을 하리라고 예상하십니까?

현재까지는 CPU 를 포함하고 있는 SoC 중에서 멀티미디어용 IC 라는 것을 구분할 수 있습니다. 하지만 멀지 않은 미래에는 이러한 구분이 없어 질 것으로 생각합니다. 왜냐하면, 예전에는 멀티미디어라는 것이 하나의 독립된 응용군으로써 존재를 하였고, 이에 따라 멀티미디어용 IC 라는 분야가 있었지만, 현재와 같은 Convergence 가 진행된다면 멀티미디어가 독립된 응용으로 존재하지 않고, 거의 모든 응용 속으로 녹아 들어 갈 것이기 때문입니다. 즉 모든 반도체가 멀티미디어 기능을 가지게 될 것이라는 것이지요. 이런 변화

에 따라가기 위해서는 멀티미디어용 IC의 미래를 현재를 기준으로 편협하게 보지 말고 전체 IT 의 방향을 봐야 합니다.

3. SoC기업이 향후 기술 개발에 집중해야 할 분야를 꼽는다면 어떤 분야를 꼽을 수 있습니까?

SoC 란 말 그대로 System On Chip 입니다. 즉 System 이라는 것이지요. 이 SoC 를 잘 만들기 위해서는 그 SoC 가 사용되는 System 에 대한 이해가 중요합니다. 저는 SoC 기업이 칩 자체의 기술 개발도 중요하지만 그 칩이 사용되는 System 에 대한 연구에 많은 시간을 투자해야 한다고 봅니다.

4. 제품 개발 과정에서 어려운 점이 있다면 어떤 점이 있습니까?

가장 어려운 점은 미래를 예측해야 한다는 것입니다. 물론 시스템 회사에서도 제품을 개발할 때 미래를 예측해야 합니다. 보통 6개월에서 1년 이후의 시장을 예측 하면 되지요. 하지만 반도체의 경우, 특이나 매직아이처럼 Application Processor를 개발하는 경우, 칩의 개발에만 최소 1년, 판매를 위한 Hardware, Software를 준비하는데 최소 6개월, 고객의 제품 개발기간 6개월이면, 제품을 기획하여 초기 판매가 발생하는데 2년이 걸리게 됩니다. 거기에 제품의 Life cycle 을 2년을 잡으면 제품 기획단계에 4년 후의 시장을 예측해야 한다는 것이지요. 요즘같이 변화가 빠른 시대에 4년 후의 시장을 예측하기 위해서는 반도체 기술의 Trend, 목표로 하는 시장에 대한 이해뿐 아니라, IT 전반에 대한 이해가 필요합니다.

5. 향후 SoC 산업이 기술적 발전을 계속하려면 무엇이 필요하다고 보십니까?

SoC 의 경쟁력을 위해서는 첨단 공정기술을 사용해야 하나, 이를 사용하기 위한 비용이 중소 규모의 SoC 회사에서 부담하기는 쉽지 않습니다. 현재 이러한 개발 비용을 분담하게 하여 비용의 부담을 줄여주는 Program 이 있지만, 그 기회를 잡기가 어렵고, 제한도 많습니다. 이러한 Program 의 확대 개편이 있다면, 국내 SoC 산업의 발전에 많은 도움이 되리라 생각합니다.

『Best Product상』수상기업
(주)에프씨아이(대표이사 윤광준)



FCI가 한국 최초로 RFIC 전문회사로 창업하여 CDMA용 RFIC 및 PAM등을 국산화 및 상용화에 성공함으로써, 삼성전자, LG전자, 팬택엔큐리텔 등 이동전화기 제조회사에 2,000만개 이상의 RF 핵심부품을 납품하여 외화와 원가를 절감하고 제품의 질을 월등히 높이는 개가를 올렸습니다. 이런 FCI의 노력은 국내 엔지니어의 자존심을 세웠으며 완전한 무선통신기술 자립화의 토대를 마련하였습니다.

FCI는 세계 최고의 Wireless Total Solution Provider를 향한 과감한 연구개발의 투자와 열정으로 세계 최고 성능의 CDMA용 수신 칩(Receiver IC), CDMA용 송신 칩(Transmitter IC), CDMA용 전력증폭기(Power Amplifier Module), PCS용 전력증폭기(Power Amplifier Module), 위성 DMB용 수신 칩(위성 Tuner IC), 지상파 DMB용 수신 칩(지상파Tuner IC) 등 제품화 성공하여 세계 최고의 RFIC Total Solution 대표기업으로 자리매김하게 되었습니다.

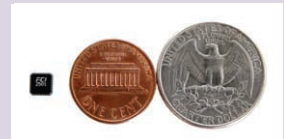
FCI는 2006년 한 해 동안 세계 최소형, 최고 성능의 T-DMB Tuner IC, 세계 최초 CDMA 송수신부 결합 칩, 세계 최초, 최소형 K-PCS 송수신 단일 칩 등 차별성 있는 세계 최고의 제품을 향한 FCI의 끊임없는 열정이 계속되고 있습니다.

수상제품 소개 : T-DMB/DAB RF Tuner IC (FC2501)

지상파 DMB/DAB용 Tuner IC인 FC2501은 그동안 FCI R&D성과인 Direct conversion용 RFIC, Power Amplifier Module, S-DMB용 Tuner IC 등 RF IC 설계 기술을 통해 숙련된 자체 전문 연구개발 인력과자체 개발된 디지털 자동화 툴, 설계과정 세분화 구체화 시스템을 통해 완성된 세계 최소형, 최고 성능의 제품입니다.

기존의 Analog TV 수신기는 높은 신호 대 잡음 비를 요구하여, 차량 이동시 신호의 간섭 현상으로 인해 수신 상태가 좋지 못하였습니다. 지상파 DMB/DAB용 Tuner IC인 FC2501은 digital 방식으로 전환된 음성, 영상의 TV신호 또는 교통 정보와 같은 데이터 전송 신호를 안테나로부터 수신하여 기저 대역의 digital 신호 처리 칩에 저 잡음, 저 전력으로 신호를 전달해 주는 역할을 합니다. 이를 통해, 고속의 차량에서도 사용자가 끊임없이 고품질의 영상 및 음성의 TV 제공을 서비스 받을 수 있게 되었습니다. 응용 및 지원 분야는 MP3, PMP, navigator, handphone 등에 활용되고 있습니다.

FC2501은 저잡음, 저전력, 소형화를 통해 기존의 analog TV 수신기에 비하여 요구되는 신호 대 잡음 비가 훨씬 낮으므로 미약한 신호도 감지해서 처리할 수 있으며 Band-II 대역, Band-III 대역, L-Band대역 등 여러 주파수 대역을 지원할 수 있어, 전 세계 어디에서든 FC2501을 이용하여 지상파 DMB를 구현할 수 있습니다. 또한 FC2501은 안테나에서의 고주파수 방송 신호를 수신하여, 2.048MHz의 낮은 중간주파수로 변환된 신호를 출력합니다.(low-IF방식)



CEO 인터뷰

윤광준 대표이사

1. 에프씨아이의 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있는 부분이 무엇입니까?

FCI는 반도체로 가장 구현이 어렵다는 CDMA의 RTX 개발에 의한 기술 집적으로 Mobile 환경에 적합한 저전력화 IC의 소형화에 세계 최고의 기술적 우월성과 차별성을 보유하고 있습니다. 당시의 IC는 경쟁사 대비 전력면에서 20% 이상, IC의 면적면에서 30% 이상의 우위를 가지고 있다고 자부합니다.



2. 현재 에프씨아이의 집중하고 있는 DMB RF Tuner IC 분야가 향후 어떤 기술적 발전을 하리라고 예상하십니까?

다가지 기술적인 추세가 예상됩니다. Mobile TV는 지역별로 다양한 표준이 사용될 것으로 판단하고 있으며, 이러한 추세를 만족하기 위해서 Multi Band를 지원할 수 있는 IC가 필요할 것입니다.

FCI의 지상파 DMB IC는 중국의 표준중 하나인 T-DMB를 동시에 지원할 수 있도록 개발되었고, DVB-H용 Tuner IC는 일본 표준인 ISDB-T를 동시에 지원할 수 있도록 개발되었습니다. 또한 다양한 표준을 모두 지원할 수 있는 IC도 현재 개발 중입니다. 다른 기술적인 추세는 Tuner와 Modulator IC의 집적화입니다. FCI는 국내 및 외국의 업체와 SIP(system in package) 형태로 집적화하여 개발되었으며 장기적으로는 Tuner와 Modulator를 원칩화하여 저전력 및 소형화를 개발할 것입니다.

3. SoC기업이 향후 기술 개발에 집중해야할 분야를 꼽는다면 어떤 분야를 꼽을 수 있습니까?

RF 또는 analog 기능을 Digital 또는 digital system IC에 집적화하여 SOC의 실질적인 완성을 추구하여야 한다고 판단합니다. 이를 위해서는 analog와 digital의 통합 시 나타나는 다양한 문제를 해결하여야 할 것이며, 현재 customized 설계 방식을 취하고 있는 analog 설계를 digital과 같이 top-down 그리고 high level 설계 방식 변환해야 합니다. 또한 점차 Digital RF의 설계를 개발해야 할 것으로 예상됩니다.

4. 제품 개발 과정에서 어려운 점이 있다면 어떤 점이 있습니까?

개발 시작단계에서 정보의 부족이 어려운 점입니다. 핵심 기능을 구현하는 것은 그동안의 기술 개발의 경험과 결과를 통해서 구현할 수 있으나 제품화의 단계에서 시스템에 대한 정보의 부족으로 사소한 기능상의 장애로 인한 시간의 소모가 매우 크게 나타나고 있습니다. 시스템상의 검증에서도 test 환경의 부족으로 선도 기술 개발에 어려움을 겪고 있는 실정입니다.

5. 향후 SoC 산업이 기술적 발전을 계속하려면 무엇이 필요하다고 보십니까?

국내의 SOC 산업은 눈부신 성장을 이루어 세계적으로 기술을 선도할 수 있는 단계에 이르렀다고 생각합니다. 이러한 발전을 계속하려면, 무엇보다도 설계 방법에 대한 진보가 이루어져야만 한다고 생각합니다. 예를 들면, TI등은 Digital RF의 설계 방법을 개발하여 RF IC의 개발에 나타나는 문제를 획기적으로 개선하고개발 기간을 단축하고 있습니다.

이러한 기술은 향후 업계의 표준이 될 것이며, 상당한 기간 산업을 이끌고 갈 것으로 판단됩니다. 다른 예는 무선통신의 Baseband IC를 DSP 기반으로 개발하여 통신 방식에 따른 실시간 Reconfigure 할 수 있는 IC를 개발하고 있습니다. 이런 방법들은 현재의 기술적 한계를 극복하고 개발을 용이하게 하여 기술의 발전을 획기적으로 견인할 것입니다.

비즈니스 상담회

중국 이동통신단말 업체 및 대형 디자인 하우스 대거 방한

이번 비즈니스 상담회에는 중국의 대표 이동통신단말 업체인 중흥통신, TCL, KONKA, ningboerd, 레노보이동통신, DATANG모바일을 비롯해 대표 디자인하우스인 CECW, 룽치, EYCOM, 셸론 등 중국의 대표적인 IT기업들이 참여한다(표 1 참조). 이들 업체는 이번 비즈니스상담회를 통하여 한국의 최신제품 발굴과 차기 신제품 개발을 위한 협력 방안 모색 등 다양한 분야에 대한 상담을 추진할 계획이다.

이번 행사에 초청된 바이어들 중 대부분이 구매 담당 부서의 부서장 또는 매니저급으로 제품 구매에 실질적인 의사 결정권이 있는 인사들이다. 또한 디자인하우스의 참여 비율이 지난 행사보다 높는데, 이번에 초청된 디자인하우스는 중국 내에서도 상위에 속하는 업체로 단순한 용역업체가 아니라 제품 자체를 디자인하여 제조업체로부터 로열티를 받는 기술력 있

는 업체들이다. 대형 디자인 하우스는 중소 제조업체보다 부품 구매력 면에서 우수하다. 또한 바이어들 중 반 이상이 자비로 본 행사에 참석하고, 전시회와 동반 개최되는 IT-SoC/임베디드 SW 컨퍼런스 2006 에도 참가를 희망할 정도로 국내 부품업체와 기술 동향 파악에 큰 관심과 의지를 보이고 있어 구성되어 어느 수출상담회보다 결실있는 비즈니스미팅이 될 것 이다.

행사개요

- 행사명 : 중국 시스템 업체 초청 1:1 비즈니스 상담회
- 일시 : 11월 1일 ~ 2일 (IT-SoC Fair 2006 행사기간)
- 장소 : 서울 삼성동 COEX 컨퍼런스센터 402호
- 주최 : 정보통신부
- 주관 : IT-SoC협회

• 초청 업체 명단

업체명	초청자	직위	관심영역	생산품목
중흥통신	Liu Shuliang	기술총감	휴대전화부품 및 DMB부품	휴대전화, 통신설비 등
	Liu Yongsheng	자재부 부장		
	Li Lin	자재부 총감		
중흥-JIXUN	Zhang Jianming	기획부 경리	DMB 부품	
DATANG 모바일	Liu Guangjun	기술총감	휴대전화부품 및 DMB부품	이동통신단말, 솔루션 등
TCL	Lin Haicheng	구매부 부장	휴대전화부품 및 DMB부품	휴대전화, 전화기, 통신단말, 전지 등
KONKA	Xiao Ping	연구소 부소장	휴대전화부품, DMB부품 및	휴대전화
	Zhang Zhongjun	구매부 부총경리	휴대전화 부가서비스	
LENOVOMOBILE	Deng Xiaoming	구매처 처장	휴대전화부품	휴대전화
	Li Zhijing	구매처 한국담당경리		
CEC Wireless	He Yu	시스템디자인 총감	휴대전화부품 및 DMB부품	IC 디자인, 휴대폰 생산 및 테스트 등
	Cao Dongtao	구매 총감		
EYCOM	Luo Guo	시스템부 부장	휴대전화부품 및 DMB부품	휴대전화, 디자인 하우스
CHINA BIRD	ESTELLE Sun	구매부 총감	휴대전화부품	휴대전화
HUAQI	Guo Hongzhi	자재부 총경리	MP3,PMP,DMB관련 부품	MP3, PMP, DMB
	Zhou Xiaochong	모바일사업부 부총경리		
LONGCHEERETE	Fan Haitao	제품기획부 총감	휴대전화부품	디자인하우스
	Tang Xiaoxun	기술총감		
CELLON	Ding Jixun	경리	휴대전화부품	디자인하우스
	Huang Liu jun	경리		
	Liu Wen hu	경리		

◎ 참가기업소개

ZTE中兴 중흥통신

ZTE Corporation은 중국에서 가장 큰 상장 텔레콤 제조사로 무선솔루션 공급자이다. 1985에 창립한 ZTE Corporation은 1997 이래 선전증권 거래소에 A급 주식회사로 상장되어 왔다. ZTE Corporation은 중국의 텔레콤 장비 제조업의 개척자이며 텔레콤 장비, 이동 터미널 및 관련 서비스의 종합 공급자이며 무선, 네트워크, 및 터미널(모바일폰)의 세 가지 제품 시리즈와 함께 ZTE는 전 세계 고객에게 다양한 통합 텔레콤 네트워크 솔루션을 제공할 수 있으며 국제 텔레콤 운용서비스 시장에 참여해왔다. 무선 제품 분야에서 ZTE는 CDMA, GSM 및 PHS 제품의 토탈네트워크 솔루션을 제공할 수 있다. 2004년 말까지 ZTE CDMA 장비의 무선 역량은 2천만 라인을 초과했으며 이에 따라 ZTE는 중국 최대의 텔레콤 장비 수출업체가 되었다. 모바일 폰은 ZTE의 업무의 또 다른 핵심으로 현재 GSM, CDMA 및 PHS 등 세 시스템의 제품을 공급하는 중국 유일의 모바일폰 제조업체이다. 모바일 폰 R&D로 주요 기술을 확보하려는 노력으로 ZTE는 모든 핵심 소프트웨어, 하드웨어 회로, 핵심 칩, 및 전체 디자인 및 통합에 관한 개별 지적재산권을 가지고 있다. ZTE는 WCDMA, CDMA, NGN, GSM, 스위칭, 접속, 및 광전송 등 ZTE의 다양한 제품으로 전 세계 60여개 국에 진입했다. 또한 ZTE는 연간 총매출의 약 10%를 연구 개발에 투자하고 있다. ZTE는 현재 21,000명의 직원이 있으며 이중 70%가 학사 이상의 학력을 소지하고 있다. ZTE는 가장 건설한 발전으로 중국 텔레콤 제조업체 중 가장 빨리 성장하는 기업 중 하나이다. ZTE는 중국의 상장 회사 중 '상위 10개 상장기업'으로 인정받았으며 '중국 증권시장 및 아시아 비즈니스에서 가장 큰 성장 잠재력을 가진 상위 50개 상장회사'에 연속해서 4년간 선정되었다.

• 중흥통신의 주요 제품 영역

- GoTa Digital Trunking 단말기 시리즈(Trunking Terminal, Trunking 기능을 구비한 고정국, 차량탐재 통신설비)
- CDMA 단말기 모듈 시리즈(800M, 450M, 1.9G 모듈)
- CDMA 고정국 시리즈(무선 데스크톱 폰, 무선 액세스 플랫폼, 소형 스위치 등)
- CDMA 데이터 단말기(CDMA 1X NIC, CDMA EVDO NIC, 무선 데이터 모듈), 무선 단말기 솔루션, 단말기 소프트웨어·하드웨어 개발 플랫폼

**DATANG 모바일**

Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd.는 2002년 2월 8일 베이징에서 등록 설립했다. 베이징에 본사를 두고 시안(西安)과 상하이에 각각 지사와 자회사를 두는 조직 구조를 형성하고 있으며, Datang Telecom Technology & Industry Group의 핵심 기업 중의 하나이다.

Datang Mobile은 국제 제3세대 이동통신기술 및 표준(TD-SCDMA)에서의 탁월한 창조를 핵심으로, '연합개발, 가상제조, 위탁경영'을 기본 경영

방침으로, 자주적 지식재산권과 개발시스템 및 단말기 전 시리즈 제품의 보유를 기초로, 공용망·시설망의 고객 어플리케이션 서비스와 고객을 위한 전면적 솔루션 제공을 자사의 소임으로, 국내외 국제 두 시장을 발전 공간으로 하여 기술창조와 산업공간이라는 두 자원적 우세를 충분히 이용하고, 온건한 경영 및 회사의 지속적인 발전을 유지함으로써 중국뿐만 아니라 세계 이동통신 영역의 선두주자가 될 것이다.

Datang Mobile은 전신과학기술연구원(Datang Telecom Technology & Industry Group) 내부에 이동통신 기술 개발 및 제품 산업화에 종사하는 우수한 자원을 확보하고 있으며, 베이징, 시안, 상하이 세 지역의 기존의 기술 축적과 기반을 바탕으로 지역적 이점을 충분히 발휘하여 통일된 계획과 합리적 분업 원칙에 따라 제품 개발 안배와 집중 관리를 실시하고 있다. 회사는 TD-SCDMA 시스템 및 단말기 제품의 대규모 상용화 업무를 적극 추진하는 한편, 중간 기술 성과의 유상 양도 및 지식재산권의 수권 허가를 중시함으로써 가치의 최대화를 보증한다. 또한 관련 기술과 응용 제품을 적극적으로 개발함으로써 다원화 시장을 형성하고, 아울러 기존의 2G 이동통신과 광대역 무선 접속 및 부가가치 서비스 등 제품을 통해 고속 성장을 이루고 있다.

TCL TCL이동통신

TCL이동통신(www.tcl.com)은 중국 이동통신 산업을 선도하고 있는 업체로서 지난 1999년 설립되었다. 특히 휴대전화 산업 분야에서 R&D, 설계, 제조, 판매 및 서비스에 이르는 토탈 솔루션을 제공하고 있다. 짧은 기간 동안 중국 내수 시장에서 강력한 브랜드 파워를 형성한데 이어 중국 통신 산업의 성장과 고객 요구를 지원하기 위해 사업을 지속적으로 확대해 왔다.

2002년 TCL이동통신은 10억 달러의 매출을 달성함으로써 중국 3대 휴대전화 제조업체로 성장했다. 2002년 말 TCL이동통신은 10억 달러의 매출을 달성함으로써 중국 3대 휴대전화 제조업체로 성장했다. 2002년 말 TCL이동통신의 전체 사업 거래규모는 과거 3년 동안 263.3배 증가하였으며 DTT의 아시아·태평양 500대 고속성장 기업에 되기도 하였다. 또한 2003년 미국 전략 분석가들을 대상으로 한 시장조사에서 TCL이동통신은 세계 이동통신 시장에서 8위 업체로 평가되었다. 2003년 4월 TCL이동통신은 국제 시장에서 효율적으로 경쟁하기 위해 이동통신 R&D, 제조, 판매, 서비스 분야와 관련한 공동 벤처를 설립하기 위해 알카텔과 협력 체제를 구축했으며, 같은 달 하이엔드 단말기 개발을 위해 영국 TTP커뮤니케이션즈와도 기술제휴 협정을 체결했다. 또한 2003년 12월 생산설비를 대폭 증강하여 연간 생산능력을 3배 가까이 확대했다. 이러한 활동들을 통해 2003년 980만대의 단말기를 판매했으며 시장점유율 10%로 중국 업체 중 2위를 차지했다. 2003년 매출은 11억 달러를 기록했으며 지난 3년간 매출액 성장률은 경이적인 2,964%를 달성했다. 현재 TCL이동통신은 50여종의 GSM, GPRS, CDMA 모델을 생산, 공급하고 있으며, 2004년 한 해 동안 600만 달러의 R&D비용을 투자하였다.

KONKA KONKA

Shenzhen Konka Telecommunications Technology Co., Ltd.는 1999년 3월에 설립되었으며, 국가 최초의 9개 GSM 이동전화 중점 생산 제조업체 중의 하나이자, 최초의 19개 CDMA 이동전화 중점 생산 제조업체 중의 하나이다.

설립 이래, 회사는 줄곧 '사람을 근본으로 한 과학기술 창조'의 취지를 계승하여 첨단 이동통신 제품의 연구개발, 생산, 판매에 진력하고 있다.

회사는 선전(Shen Zhen)과 미국의 실리콘밸리에 연구기구를 보유하고 있으며, 현재는 이미 Konka 영웅본색 시리즈, 효설(曉雪) 시리즈, Angel 시리즈, Oscar 시리즈, 초장대기(超長待機) 시리즈, 음향 시리즈 등 시리즈 제품을 포함한 수십 종의 인기 판매 제품을 출시했다.

회사는 현재 국제 수준의 SMT 생산라인 4개와 자주적 지식재산권을 지닌 이동전화 생산 라인 10개를 갖추고 있으며, GSM과 CDMA 이동전화 대규모 생산 테스트 기술을 전면적으로 장악하고 있다. 연간 1,000만대 이상의 이동전화를 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다.

회사는 전국에 마케팅 네트워크를 구축하고 있으며, 20개의 판매 지사를 보유하고 있다. 이동전화의 국내시장 점유율은 현재 국내 동종 업계에서 3위 안에 포함된다. 또한 전국을 아우르는 A/S시스템을 구축하여 소비자에게 최고의 서비스를 제공하고 있다.

최근 몇 년 간, KONKA는 시중 업계 인솔자의 모습으로 소비자의 앞에 출현하였으며, 단계적 쾌속 발전을 구현했다.

2004년, '이미지 전략'을 개전하여 이미지 핸드폰 세분화 시장에서 선두 자리를 차지했으며, 전체 핸드폰 판매량은 500만대의 관문을 돌파하여 무난히 국산 중 3위안에 진입했다.

lenovo LENOVO 모바일

Lenovo Mobile Communication Technology Ltd.는 이동통신 제품 및 서비스 제공업체로서 2002년 정식으로 설립되었다.

현재까지 Lenovo Mobile은 5대 시리즈 핸드폰 제품을 출시했다. 그 중에는 국내시장 최초의 40화음 핸드폰인 G808, 국산 최초의 MMS 핸드폰인 G818, 최초의 향수 핸드폰인 V508, 최초의 국산 100만 화소 핸드폰인 V8500이 포함되어 있다. 첨단 제품인 컴퓨터 핸드폰 ET180, ET960 등은 모두 우수한 기능과 탁월한 성능으로 시장에서 인정을 받았다. 그 중, 지능형 컴퓨터 핸드폰인 ET960은 2005년 6월 미국 <Business Week>가 주최한 'IDEA상(Industrial Design Excellence Award)'을 수상했으며, 이는 국산 핸드폰 제조업체가 최초로 획득한 국제 대상이다. 현재 Lenovo Mobile은 기술적 우세를 기반으로 100만 화소 시대를 선도해 나아가고 있다. TDS-CDMA 연맹의 구성원 중 하나로서 Lenovo Mobile은 3G의 발전을 적극 추진하고, 3G 핸드폰의 자체 연구개발을 견지하고, 3G 단말기의 핵심기술 장악에 진력하고, Lenovo Mobile 단말기의 연구개발 기술 영역의 핵심적 경쟁력을 창조한다.



CEC Wireless

CEC Wireless는 전세계의 OEM업체와 자체상표를 붙이는 Distributor에게 모듈, 플랫폼과 단말기 완제품을 제공하고 있다. CECW는 실리콘밸리의 관리 패턴을 도입하여 미국, 한국, 프랑스, 캐나다 등에 R&D 센터를 운영하고 있으며, 국내외 우수한 기업들과 협력하고 있다. 2001년 8월, CECW는 PCC와 합병하여 PCC의 R&D센터를 인수하였고 이로써 전세계 최대 규모의 독립 무선 디자인하우스가 되었다. CECW는 국제시장을 공략하기 위해 글로벌 판매망과 기술지원시스템 그리고 재료 아웃소싱망을 구축했다. CECW는 OEM과 ODM을 동시에 하는 고객을 지원할 수 있으며 또한 많은 고객들이 완전한 제품 라인을 설립하는데 도움을 주고 있다. 주요 상품으로는 CMS92, CMS91, CW, YTR01무선모듈 등이 있으며 필립스, Xelibri, 하이얼, KONKA 등에게 주로 공급하고 있다.



EYCOM

SHEN ZHEN EYCOM TECHNOLOGY Co., Ltd.는 이동통신 제품의 연구개발, 생산, 판매 및 A/S에 종사하는 하이테크 기업이다. 본사는 선전시 푸톈구(福田區) 후베이빌딩(湖北大廈)에 위치하고 있으며, 200명에 육박하는 연구개발 기술자를 보유하고 있다. 아울러 둥관시(東莞市)에 12만 평방미터에 달하는 현대화된 핸드폰 생산기지를 보유하고 있으며, 국가 핸드폰 생산 허가증을 획득했다.

EYCOM은 튼튼한 경제적 기반, 강력한 연구개발 능력, 융통적인 인센티브 메커니즘 및 현대적 관리 수단을 갖추고 있으며, 이동통신 업계의 많은 핵심 기업과 가맹을 맺고 있다. EYCOM은 2003년에 RMB 약 천만 위안을 투자해 세계적으로 저명한 IC 제조기업인 인피니온(Infinion)과 핸드폰 연구개발 합작을 진행하여 현재까지 인피니온 방안에 기반한 수십 종의 제품을 손조롭게 출시했다.



닝보버드

NINGBO BIRD Co., Ltd.는 전문적으로 이동통신 제품의 개발, 제조, 판매에 종사하는 하이테크 상장회사로서 국가과학기술부와 중국과학원의 하이테크기업 평가를 통과한 국가 등급의 중점 하이테크기업이다. 회사는 저장성(浙江省) 닝보시(寧波市)에 위치하고 있으며, 1992년 10월에 설립되었다. 주요 제품으로는 이동전화, PDA, 시스템설비 등이 있다.

BIRD는 매년 판매수입의 6%를 자주적 연구개발에 사용하고 있으며, 다년간의 발전을 통해 BIRD는 이동통신 단말기 제품의 개발에 있어서 국내 일류 수준을 갖추게 되었다. 2005년 BIRD는 통신, 오디오, 비디오 등의 첨단 기술을 정합해 MP4 시리즈 핸드폰을 보급하여 핸드폰을 '촬영, 음악 취취, TV 시청'의 새로운 Mobile Entertainment 시대로 끌어올렸다.

1999년에 ISO9001 품질경영시스템 인증을 통과했고, 2002년 7월에 2000버전 ISO9001 품질경영시스템 인증서를 획득했다. 현재 BIRD는 ISO14000 환경품질시스템 인증 업무를 적극적으로 추진하고 있다. BIRD

핸드폰은 '사용자 만족 브랜드상', '사용자 만족 디자인상', '사용자 만족 기능창조상' 등의 대상을 여러 차례 수상했다. 2005년, '제6회 CCID 중국 핸드폰 사용자 만족 제품 조사'에서 '사용자 만족 브랜드', '사용자 만족 품질상', '사용자 만족 엔터테인먼트 핸드폰상' 등의 네 항목에서 대상을 수상했다.

또한 30개의 지사와 400여 개의 사무소와 15,000여 개의 판매대리점을 설립했으며, 국내에 전국의 성, 지구, 시를 아우르는 3급 서비스망을 구축했다. 또한 전국의 대·중형 도시에 36개의 성급 고객센터를 자체 설립했으며, 2~3급 도시에 약 400개의 지구·시급 고객센터를 자체 설립했으며, 현과 발달한 향촌에 2,000여 개의 특약 A/S센터를 설립했다.

BIRD는 2004년부터 수출을 시작하여 급속히 발전하고 있으며, BIRD 브랜드 핸드폰의 수출은 이미 오대주 60여 국가와 지역을 아우르고 있다. 2005년, BIRD 핸드폰은 1,393만 대가 판매되어 국산 브랜드 핸드폰 판매량에 있어서 6연패를 달성했으며, 611만 대를 수출하여 기타 모든 국산 브랜드의 핸드폰 총 수출량을 합한 대수를 초과했다. 이는 국산 브랜드 핸드폰 수출 총량의 60% 이상을 점유한 것으로서 국산 브랜드 핸드폰 수출 총량에서 월등한 우위를 점하고 있는 것이다. 전세계에 이미 1,000만 대 이상이 수출되었으며, 전세계 누계 판매량은 5,000만대를 돌파했다.

aigo 爱国者 화기정보통신

1993년에 설립된 Beijing Huaqi Information Digital Technology Co., Ltd.는 베이징 중관촌(Zhong Guan Cun)의 중심부에 본사를 둔 하이테크 회사이다. 화기는 휴대용 저장장치, 디지털 제품, 자체조립(self-assembling) 제품 등의 분야를 선도하는 중국내 제조업체로서 항상 중국 IT 산업의 발전을 자사의 사명으로 여기고 있다. 화기는 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 제품의 R&D, 판촉 및 서비스에 종사하고 있다. 휴대용 저장장치, 모니터, 디지털 제품, 컴퓨터 케이스, 광자기 제품 등을 비롯한 aigo 시리즈 제품은 최고급품의 대명사로 자리잡고 소비자들의 폭넓은 사랑을 받고 있다.

화기의 매출 수익은 1993년 설립 이래 10년 넘게 60%씩 꾸준한 증가를 유지해 왔다. 본사의 제품은 북미, 유럽, 동남아시아 등의 지역에 수출되고 있다. AIGO 플래시메모리 시리즈는 지난 5년간 최대의 시장 점유율을 기록하면서 중국 시장을 지배해 왔다. AIGO MP3 플레이어 시리즈는 출시된 지 불과 1년 만에 수많은 브랜드를 제치고 매출액 1위를 기록했으며 줄곧 수위 자리를 지켜오고 있다. AIGO MP4는 중국 시장 최고의 브랜드가 되었다. AIGO 모니터와 주변장치는 국내 시장에서 수위를 차지해 왔으며, 그 중에서도 컴퓨터 케이스는 다년간 최대의 시장 점유율을 기록했다. 화기는 중국 IT 산업에서 최고의 기업 중 하나가 되었다.

Huaqi는 1,500명이 넘는 종업원을 보유하고 있다. 베이징의 본사 외에도 중국 내에 17개의 자회사와 지역 사무소가 있으며, Huaqi Information Technology(싱가포르) PTE Ltd, Huaqi Information Technology(프랑스) PTE Ltd, Huaqi Information Technology(인도) PTE Ltd., aigo 디지털 뮤

직 웹사이트, aigo Research and Development Co., Ltd., Huaqi Image Data Intelligence Technology Co., Ltd., Beijing aigo Chess Club(BACC) 등을 비롯한 계열회사들이 Beijing Huaqi Information Digital Technology Co., Ltd.를 중심으로 방대한 기업 그룹을 형성하고 있다.

LONGCHEER 龙旗控股 LONGCHEER GROUP

Longcheer Group은 핸드폰의 연구개발과 설계에 전문적으로 종사하는 하이테크 기업으로서, 700여명의 연구개발 기술자가 포함된 1,000여명의 임직원을 보유하고 있는 중국 3대 핸드폰 설계회사 중의 하나이다. Longcheer Group은 2002년 7월에 설립되어 3년 내에 싱가포르 증권거래소에 성공적으로 상장했으며, Longcheer Group이 2005년 12월까지 시장에서 모집한 자금은 약 1억 위안에 달한다. Longcheer는 중국의 3대 핸드폰 설계 솔루션 제공업체 중의 하나이자 중국에서 성장이 가장 빠른 50대 하이테크 기업 중의 하나이다. 2005년에는 중국 하이테크, 고성장 기업 50강 중 14위에 랭크되었으며, 아시아태평양 지역 고성장 기업 500강 중 59위에 랭크되었다.

Longcheer Group은 고객의 원가절감, 시장 진입 시간 단축, Win-Win 획득을 전력 지원한다는 경영이념으로 GSM/GPRS/3G 이동단말기의 연구개발에 진력하여 고객에게 완전한 이동단말기 솔루션을 제공하고자 노력하고 있다. 연구개발에는 2.5G에서 3G에 이르는 제반 핸드 디바이스가 포함되며, 또한 사진 촬영, MMS, JAVA, WAP, MP3, MPEG4, MDTV 등과 같은 창조적 기술 영역에서 탁월한 연구개발 능력을 갖추고 있다. 설계의 개념으로부터 제품의 구현에 이르기까지 전체적인 설계 방안에는 하드웨어, 소프트웨어 및 외부설비가 포함된다. 또한 당사는 전신(통신류) 고객에게 CKD(Complete Knocked Down)와 SKD(Semi Knocked Down) 설계 솔루션도 제공하고 있다. 제품의 품질을 보증하기 위하여 설계와 생산의 전 과정에 대한 엄격한 품질제어 테스트를 시행하고 있다.

Cellon 셀론

셀론은 무선핸드폰업계에 종단간 디자인 및 시스템 통합 서비스를 공급해온 선도업체이다. 셀론은 전 세계 핸드폰 OEM 및 소매업체에 최종 플랫폼과 완전히 아웃소싱된 솔루션을 공급한다. 600여명의 직원의 노력으로 글로벌 서비스를 공급하고 있다. 게다가 셀론은 선도 기술업체와 제3자 소프트웨어 개발업자와 전략적 제휴관계를 유지해왔다. 지금까지 셀론의 디자인으로 2천5백만대 이상의 무선 핸드폰이 시장에 자리 잡아왔다.

유럽과 아시아에 디자인 시설을 갖춘 셀론은 가장 중요한 독립 R&D, 소프트웨어, 하드웨어 아키텍처를 갖추고 있으며 현재 및 차세대 모듈 및 플랫폼을 위한 시스템 통합 능력을 갖추고 있다. 셀론은 전 세계 R&D 및 디자인 능력을 활용해서 주요 고객이 최종 개발되고 시험되고 구현되는 최첨단 기술을 선택 이용할 수 있도록 돕고 있다.

IT-SoC/임베디드 SW 컨퍼런스 2006

'IT-SoC/임베디드 SW 컨퍼런스 2006' 행사가 오는 2006년 11월 1일부터 2일까지 2일간 코엑스(COEX) 컨퍼런스 센터에서, 국내 유일의 SoC 전시회인 'IT-SoC Fair 2006' (www.it-soc.org)과 동시에 열린다.

이번 행사에서는 'Digital Convergence & Fusion Technology'를 주제로, IT-SoC/융합부품 및 임베디드 소프트웨어 기술의 발전 방향과 주요 시장 및 시스템의 변화에 대해 심도있는 논의가 이루어 질 것이다.

또한, 약 40여명의 국내외 연구소, 학계, 산업체의 최고 전문가들이 주제발표자로 나서 약 500여명 이상의 정보통신관련 종사자와 고급 정보를 나눌 것으로 기대된다.

1. 행사 개요

- 행사명 : IT-SoC/임베디드 SW 컨퍼런스 2006
- 일 시 : 2006년 11월 1일 ~ 2일 (2일간)
- 장 소 : COEX 컨퍼런스 센터 320호, 321호, 330호
- 주 최 : 정보통신부
- 주 관 : 정보통신연구진흥원, 한국전자통신연구원, IT-SoC협회, 임베디드소프트웨어산업협의회

2. 발표 주제

- 모바일 TV
- 멀티미디어
- 무선통신
- 융합기술 및 센서
- SoC 기반기술
- 임베디드소프트웨어 기반기술
- 임베디드소프트웨어 활용기술
- 임베디드소프트웨어 미들웨어 및 개발 기술

3. 프로그램

날짜	시간	주제	발표자
11/1	10:00 ~ 11:00	등록	
		Keynote (320호)	
	11:00 ~ 11:40	휴대폰 기술 발전과 SoC	안승권 부사장, LG전자
	11:40 ~ 12:20	The Market Outlook for SoC Opportunities	Greg Sheppard 수석부사장, iSuppli
		Session 1 : Mobile TV (320호) 좌장 : 박장현 박사, ETRI	
	14:00 ~ 14:40	Mobile TV Devices Market Trend	Takeshi Niwa, Techno Systems Research
	14:40 ~ 15:20	Mobile TV SoC solution	이도준 상무, 삼성전자
	15:20 ~ 15:40	Coffee Break	
	15:40 ~ 16:20	SoC for Mobile TV	곽국연 연구위원, LG전자
	16:20 ~ 17:00	Multi-mode Multi-band Tuner Solution	김보은 연구소장, 인티그라트

날짜	시간	주제	발표자
11/2		Session 2 : 멀티미디어 (321호) 좌장 : 장선호 박사, IITA	
	14:00 ~ 14:40	이동 멀티미디어 컨버전스 서비스	장원학 팀장, KTF
	14:40 ~ 15:20	Application Processor for Next Generation Mobile Devices	이윤태 상무, 삼성전자
	15:20 ~ 15:40	Coffee Break	
	15:40 ~ 16:20	멀티미디어 어플리케이션 프로세서의 설계 동향과 전망	이석중 부사장, 코아로직
	16:20 ~ 17:00	Mobile Multimedia Trends and SoC Solution	강세진 상무, 엠택비전
		Session 3 : 임베디드 SW 기반기술 (330호) 좌장 : 김장국 교수, 한국외국어대학교	
	14:00 ~ 14:40	Microsoft Windows Embedded	Sheng-Hsiung Eddie Business Strategy Wu, Managing Director, Microsoft
	14:40 ~ 15:20	리눅스 기반 임베디드 SW 플랫폼 기술개발 동향 및 방향	김재명 팀장, ETRI
	15:20 ~ 15:40	Coffee Break	
	15:40 ~ 16:20	디바이스 소프트웨어 발전 방향	이창표 지사장, Windriver Korea
	16:20 ~ 17:00	임베디드 SW개발의 해결방안, 모델기반설계	이정민 이사, The MathWorks Korea
	09:00 ~ 09:30	등록	
		Session 4 : 무선 통신 I (320호) 좌장 : 방승찬 그룹장, ETRI	
09:30 ~ 10:10	이동통신 시장 및 기술 동향	조승호 교수, KAIST	
10:10 ~ 10:50	이동통신 네트워크 및 서비스 발전방향	하성호 상무, SK텔레콤	
10:50 ~ 11:10	Coffee Break		
11:10 ~ 11:50	WiBro의 발전 방향	정관영 상무, KT	
11:50 ~ 12:30	RFID/USN 시장 및 기술동향	함일한 팀장, LG CNS	
	Session 5 : 융합기술 및 센서 (321호) 좌장 : 박효덕 본부장, KETI		
09:30 ~ 10:10	IT · BT 융합기술의 현재와 미래	박선희 그룹장, ETRI	
10:10 ~ 10:50	나노바이오 센서의 IT 산업에의 응용	홍승훈 교수, 서울대	
10:50 ~ 11:10	Coffee Break		
11:10 ~ 11:50	USN용 sensor 기술	황학인 박사, KETI	
11:50 ~ 12:30	자동차용 반도체 시장과 기술	최창희 연구소장, 현대오일넷	
	Session 6 : 임베디드 SW 활용기술 (330호) 좌장 : 임성수 교수, 국민대학교		
09:30 ~ 10:10	임베디드 환경에서의 오픈소스 적용과 이슈	최영규 상무, 삼성전자	
10:10 ~ 10:50	국방 임베디드소프트웨어 발전방향	손태중 박사, 한국국방 연구원	
10:50 ~ 11:10	Coffee Break		
11:10 ~ 11:50	유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 임베디드 데이터베이스	최윤석 이사, 한국 오리클	
11:50 ~ 12:30	모바일 브라우저의 기술 동향	김경남 연구소장, 인프라웨어	
	Session 7 : 무선 통신 II (320호) 좌장 : 김재준 사무관, 정보통신부		
14:00 ~ 14:40	차세대 이동통신을 위한 Key Technology	김경호 상무, 삼성전자	
14:40 ~ 15:20	무선데이터 통신의 발전방향	김학선 상무, 삼성전기	
15:20 ~ 15:40	Coffee Break		
15:40 ~ 16:20	국내 UWB SoC 개발	최상성 팀장, ETRI	
16:20 ~ 17:00	ZigBee의 기술 및 응용 분야	왕성호 대표, 레이디오피스	
	Session 8 : SoC 기반기술 (321호) 좌장 : 엄낙웅 그룹장, ETRI		
14:00 ~ 14:40	Nano-Watt Design for Nano-Meter Technology	신영수 교수, KAIST	
14:40 ~ 15:20	System Level Verification for HW/SW co-design	기안도 연구소장, 다이나믹시스템	
15:20 ~ 15:40	Coffee Break		
15:40 ~ 16:20	Low Noise Design of System-In-Package: RFID, DMB, ZigBee, UWB, X/Ku Band Transceiver, SerDes Channel SIP	김정호 교수, KAIST	
16:20 ~ 17:00	Multi-Processor SoC	채수익 교수, 서울대	
	Session 9 : 임베디드 SW 미들웨어 및 개발 기술 (330호) 좌장 : 김기철 사무국장, 임베디드소프트웨어산업협의회		
14:00 ~ 14:40	임베디드 서비스를 위한 플랫폼과 브라우저	황남주 부사장, 지오텔	
14:40 ~ 15:20	자바 UI 플랫폼 소개	연승익 이사, 벨록스소프트	
15:20 ~ 15:40	Coffee Break		
15:40 ~ 16:20	임베디드 시스템과 개발환경	노상태 부사장, 아이지시스템	
16:20 ~ 17:00	임베디드 SW의 통합개발도구(Visual Esto)	조주현 대표이사, 코스모	

IT SoC 2006 Job Fair

IT SoC전공인증 과정에 참여한 석박사 학생, 특히 2007년 2월 졸업예정자들을 대상으로 인력양성 후원기업과의 채용면담을 주선하여 우수한 인력의 효과적 채용을 지원하고자 한다. IT SoC전공인증과정 참여 학생들에게는 타 학생들과의 차별성을 알려 취업의 기회를 확대하는 장으로, 기업에게는 우수 인력을 확보할 수 있는 기회로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 작년에 이어 두 번째로 개최되는 IT SoC Job Fair가 성공적으로 진행되어 학생과 기업 모두 만족할 만한 성과가 있기를 기대해 본다.

1. 개최 기간 및 장소

: 2006. 11. 1. ~ 2. 서울 코엑스 인도양홀
(IT-SoC Fair 2006과 동시 진행)

2. Job Fair 참가대상

가. 기업

- 2005~2006년 IT SoC인력양성 후원기업
- IT SoC산업진흥센터 창업보육기업 및 매출 10억 미만 기업
- 2006년 IT SoC인력양성 후원기업 추가모집 기업

나. 학생

- IT SoC 전공인증과정 석·박사 졸업(예정) 및 과정 중인 학생 1,500여명
- 특히 2007년 2월 졸업예정 인원 400여명

3. Job Fair 참가기업 지원사항

- 참가기업 Directory 배포 : 기업 소개 및 채용계획 안내
- 현장 면담 부스 및 필요사항 지원
- 기업별 개별 요구사항은 별도 협의 후 지원

4. Job Fair 진행

- 참가기업 확정 후 해당기업에 한하여 학생의 면접신청을 받을 예정
- 학생-기업간 면접 매칭하여 스케줄 확정
- 필요시 현장에서 추가로 전공인증과정 학생 대상 면접 주선

5. Job Fair 신청 문의

: SoC산업진흥센터 SoC아키텍트양성팀 김현주
(kimhj1@etri.re.kr, 02-3433-6036)

